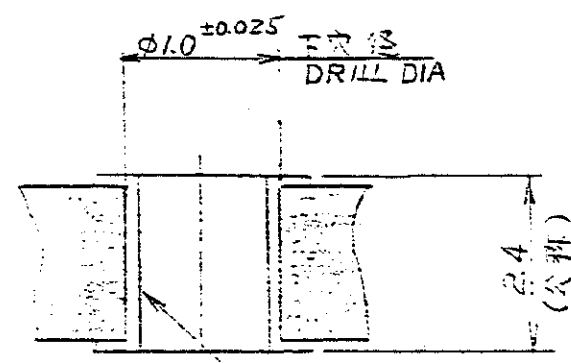


注記

- △ 1.3μ以上のニッケルメッキの上に I の範囲に 0.76μ最小の金メッキ、II の範囲はアクショニアrea に 0.1μ最小の金メッキを施す
- △ 1.3μ以上のニッケルメッキの上に I の範囲に 0.76μ最小の金メッキ、アクショニアrea に 0.1μ最小の金メッキを施す
- △ 3-6 は A.B.C 列のみ IC 90° を挿入してある
- △ 4,5 は A.B 列のみ IC 90° を挿入してある

NOTES

- △ 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA
- △ 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA.
- △ 3-6: INSERT CONTACTS ROW A, B, C ONLY
- △ 4,5: INSERT CONTACTS ROW A, B ONLY
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



銅メッキ厚 25μ~76μ
Cu PL.-THRU HOLE 25μ~76μ THK
基板推奨寸法
RECOMMENDED HOLE SIZE

OBSOLETE

△	△	△	△	9.4 REF.	△							2
120	80			16.9 REF.	△	銅合金 COPPER ALLOY	703	20°C	ポスト	ACTION PIN POST		2
1	1	1	1			ガラス/PBT FILLED PBT	AW-9	110°	27	HDR-HSG		1
-6	-5	-4	-3	-2	-1	703	20°C	5	仕上	材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM NO.

© 1987 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP		AMP TOKYO, JAPAN	
WIRE RANGE	INSULATION DIA.	NAME	
AWG		HDR ASS'Y	
MATERIAL		SEE TABLE	
FINISH		SEE TABLE	
REV.		REV.	
DATE		DATE	
CHK		CHK	
APP		APP	
LTR		LTR	
REVISION RECORD		DR. CHK. DATE	
B1 REVISED PER ECO-09-022424		KK 01709/09	
B: -5 追加 J10980 DIA.		10/3	
A: -6 追加 J12080 DIA.		10/3	
O: 4E 追加 J1515 DIA.		10/3	
SYZE		LOC	
C J		C-174350	
REV.		REV.	
B1		SHEET 1/1	

単位: 11 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)